

## Plaskon AMC-2RC

Епоху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

### Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound specifically formulated for encapsulation of stress sensitive electronic devices including DIPs, SOICs, SSOPs and PLCCs. It can be used in conventional or automold applications.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкая вязкость Ускоренная Настройка		
Используется	Электрическое/электронное применение Применение в автомобильной области		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.91	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1.66	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	0.0132	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	147	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (1.50 mm)	31	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.55		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	2.0E-3		ASTM D150
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: 5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 3 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 76 cm Automatic Orifice Viscosity, 175°C, Shear Rate is 100000 sec<sup>-1</sup>, 1 mm die length, 1/2 mm diameter: 70 poise Ram Follower Gel Time, 175°C: 10 sec Ash Content: 79 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Cull Hot Hardness, Shore D, 75 sec, 175°C: 72 All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 14 cm<sup>-6</sup>/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 60 cm<sup>-6</sup>/cm/°C

The following information was transfer molded and post cured for 6 hours at 175°C

Glass Transition Temperature T<sub>g</sub>: 155°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 12 cm<sup>-6</sup>/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 61 cm<sup>-6</sup>/cm/°C

## Инструкции по впрыску

Conventional Resin Transfer Molding:

Preheat Temperature: 85 to 95°C

Molding Temperature: 175°C

Molding Pressure: 56 to 98 kg/mm<sup>2</sup>

Cycle Time: <90 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 2 hr

Transfer Time: 8 to 15 sec

Auto Resin Transfer Molding:

Transfer Time: 6 to 12 hr

Cycle Time: 30 to 60 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 2 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat